

【113 學年度第 1 學期起適用】
113.11.12 113 學年度第 1 學期學分學程會議通過
113.12.12 第 182 次教務會議通過

跨領域智慧製造學程新課程規劃表

	開課單位	課程名稱	學分	備註	
核心課程	機電系	智慧製造聯網整合技術	3		
	機電系	智慧製造與監測技術	3		
核心課程學分數：3 學分					
選修	電機系	訊號與系統	3		
	機電系	物聯網與大數據於智慧製造應	3		
	機電系	微機電系統概論	3		
	資工系	SystemC 與數位系統設計概論	3		
	資工系	資料探勘	3		
	資工系	機率學	3		
	資工系	無線網際網路	3		
	資工系	人工智慧導論	3		
	資工所	核心基礎的機器學習	3		
	材光所	傅氏光學	3		
	光電系	富氏光學	3		
	光電系	雷射加工原理、應用與實作	3		
	光電系	雷射導論	3		
	應數系	統計學習與資料探勘	3		
	資管所	巨量資料分析導論	3		
	資管所	巨量資料分析實務	3		
	工學院	資訊安全概論	2		
		臺灣大專院校人工智慧學程聯盟	人工智慧導論	3	
		臺灣大專院校人工智慧學程聯盟	機器學習	3	
		臺灣大專院校人工智慧學程聯盟	資料探勘與應用	3	
總學分數：至少 15 學分					

※【整合學程】課程規劃至少 15 學分。

※【整合學程】學生所修習之學程課程中，至少應有 6 學分不屬於學生本系所、雙主修及
輔系之課程。

※修習學程適用之課程規劃表請依核准修習學年期版本為主。

【112 學年度第 1 學期起適用】
112.11.7 112 學年度第 1 學期學分學程會議通過
112.12.12 第 178 次教務會議通過

跨領域智慧製造學程新課程規劃表

	開課單位	課程名稱	學分數	備註
核 心 課 程	機電系	智慧製造與監測技術	3	
	半導體封測所	智慧製造與控制實務	3	
核心課程學分數： 3 學分				
選 修	電機系	訊號與系統	3	
	資工系	資料探勘	3	
	資工系	機率學	3	
	資工系	無線網際網路	3	
	資工系	人工智慧導論	3	
	應數系	統計學習與資料探勘	3	
	資管所	巨量資料分析導論	3	
	電機系	資料結構	3	
	電機系	機器學習系統設計實務與應用	3	
	機電系	精密機械製造	3	
	機電碩	類神經網路概論	3	
	資工系	物件導向程式設計	3	
	資工系	機器學習導論	3	
	管理學院(碩)	大數據分析、機器學習、與人工智慧方法	3	
	應數碩	Python 與機器學習之理論實現	3	
	應數碩	大數據平行計算	3	
	機電碩	深度學習理論與應用	3	
總學分數：至少 15 學分				
※【整合學程】課程規劃至少 15 學分。				
※【整合學程】學生所修習之學程課程中，至少應有 6 學分不屬於學生本系所、雙主修及輔系之課程。				
※修習學程適用之課程規劃表請依核准修習學年期版本為主。				

【111 學年度第 1 學期起適用】
111.10.31 111 學年度第 1 學期學分學程會議通過
111.12.5 第 174 次教務會議通過

跨領域智慧製造學程新課程規劃表

	開課單位	課程名稱	學分數	備註
核 心 課 程	機電系	智慧製造與監測技術	3	
核心課程學分數： 3 學分				
選 修	電機系	訊號與系統	3	
	資工系	資料探勘	3	
	資工系	機率學	3	
	資工系	無線網際網路	3	
	資工系	人工智慧導論	3	
	應數系	統計學習與資料探勘	3	
	資管所	巨量資料分析導論	3	
	電機系	資料結構	3	
	電機系	機器學習系統設計實務與應用	3	
	機電系	精密機械製造	3	
	機電碩	類神經網路概論	3	
	資工系	物件導向程式設計	3	
	資工系	機器學習導論	3	
	管理學院(碩)	大數據分析、機器學習、與人工智慧方法	3	
	應數碩	Python 與機器學習之理論實現	3	
應數碩	大數據平行計算	3		
機電碩	深度學習理論與應用	3		
總學分數：至少 15 學分				
※【整合學程】課程規劃至少 15 學分。 ※【整合學程】學生所修習之學程課程中，至少應有 6 學分不屬於學生本系所、雙主修及輔系之課程。 ※修習學程適用之課程規劃表請依核准修習學年期版本為主。				

【110 學年度第 1 學期起適用】
110.11.2 110 學年度第 1 學期學分學程會議通過
110.12.28 第 170 次教務會議通過

跨領域智慧製造學程新課程規劃表

	開課單位	課程名稱	學分數	備註
核心課程	機電系	智慧製造聯網整合技術	3	
	機電系	智慧製造與監測技術	3	
核心課程學分數：3 學分				
選修	電機系	訊號與系統	3	
	機電系	物聯網與大數據於智慧製造應用	3	
	機電系	微機電系統概論	3	
	資工系	SystemC 與數位系統設計概論	3	
	資工系	資料探勘	3	
	資工系	機率學	3	
	資工系	無線網際網路	3	
	資工系	人工智慧導論	3	
	資工所	核心基礎的機器學習	3	
	材光所	傅氏光學	3	
	光電系	富氏光學	3	
	光電系	雷射加工原理、應用與實作	3	
	光電系	雷射導論	3	
	應數系	統計學習與資料探勘	3	
	資管所	巨量資料分析導論	3	
	資管所	巨量資料分析實務	3	
	工學院	資訊安全概論	2	
總學分數：至少 15 學分				
<p>※【整合學程】課程規劃至少 15 學分。</p> <p>※【整合學程】學生所修習之學程課程中，至少應有 6 學分不屬於學生本系所、雙主修及輔系之課程。</p> <p>※修習學程適用之課程規劃表請依核准修習學年期版本為主。</p>				

【108 學年度第 2 學期起適用】
109.5.4 108 學年度第 2 學期學分學程會議通過
109.5.28 第 164 次教務會議通過

跨領域智慧製造學程新課程規劃表

	開課單位	課程名稱	學分數	備註
核 心 課 程	機電系	智慧製造聯網整合技術	3	
核心課程學分數：3 學分				
選 修	電機系	訊號與系統	3	新增課程
	機電系	智慧製造與監測技術	3	
	機電系	物聯網與大數據於智慧製造應用	3	
	機電系	微機電系統概論	3	新增課程
	資工系	SystemC 與數位系統設計概論	3	課名異動
	資工系	資料探勘	3	新增課程
	資工系	機率學	3	新增課程
	資工系	無線網際網路	3	新增課程
	資工系	人工智慧導論	3	新增課程
	資工所	核心基礎的機器學習	3	
	材光所	傅氏光學	3	
	光電系	富氏光學	3	課名異動
	光電系	雷射加工原理、應用與實作	3	課名異動
	光電系	雷射導論	3	
	應數系	統計學習與資料探勘	3	
	資管所	巨量資料分析導論	3	
	資管所	巨量資料分析實務	3	
	工學院	資訊安全概論	2	新增課程
總學分數：至少 15 學分				
※【整合學程】課程規劃至少 15 學分。				
※【整合學程】學生所修習之學程課程中，至少應有 6 學分不屬於學生本系所、雙主修及輔系之課程。				
※修習學程適用之課程規劃表請依核准修習學年期版本為主。				